

Product Change Notice

(管理番号：CST-R2-AJ127 Rev.1.0)

2018年8月1日

通知先:	お客様各位
変更のご案内:	<p>平素より大変お世話になります。</p> <p>今般 PCN を発行させて頂くにあたり、御社より受注または将来の需要見込みを頂いているため、変更通知をさせて頂きます。当該通知の内容となりますので何卒ご了承頂きます様お願い申し上げます。</p> <p>対象製品は添付の製品リストをご参照ください。</p>
変更内容の説明:	Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd. 組立 SRAM 製品：組立拠点および組立材料等の変更
変更理由:	<ul style="list-style-type: none"> ・供給安定性を目的とした組立拠点の変更 ・供給安定性および実装信頼性の更なる向上を目的とした組立材料の変更
識別方法:	<ul style="list-style-type: none"> ・出荷梱包ラベルに記載の発注型名により、製品識別が可能
影響の有無:	<ul style="list-style-type: none"> ・組立材料、チップ厚変更 ・防湿梱包性能変更 (対象パッケージ：28pin-SOP, 52pin-μTSOP, 36pin-SOJ, 44pin-SOJ) ・梱包仕様変更 (対象梱包：マガジン梱包品、テープ&リール梱包品)
出荷開始予定日:	<p>52pin-μTSOP, 36pin-SOJ, 44pin-SOJ：2019年6月</p> <p>28pin-SOP, 32pin-SOP：2019年11月</p>
補足説明:	本通知書 3～6 ページと、別紙 (CST-R2-AJ127 補足資料) をご参照下さい。
問合せ先:	<p>ルネサス エレクトロニクス株式会社</p> <p>ブロードベースソリューション事業本部 インダストリアル A & P 事業部</p> <p>アナログ製品部 汎用メモリ製品課</p>
添付資料:	別紙：CST-R2-AJ127 補足資料
<p>ご不明な点がございましたら、弊社営業、特約店または代理店までご連絡ください。</p>	

PCN に関する御注意

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させて頂きます。
2. お客様より受理の御連絡を頂いた後、承認手続きのための条件がございましたら 90 日以内に御連絡をお願い致します。受理御連絡後 90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させて頂きます。
3. 変更内容についてご承認いただけない場合、最終注文数のご提示とご発注をお願い致します。

お客様 御連絡用紙 (PCN tracking number: CST-R2-AJ127)

万が一、本 PCN に対し適用できない理由がある場合に御連絡をお願い致します。
(e-mail または郵送で御返信を御願い致します)

御記入日: _____

御社名: _____

部門: _____

e-mail アドレス: _____

電話番号: _____

御署名: _____

適用できない理由

1. 変更する背景

このたび弊社では、Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd.にて組立を実施している SRAM 製品（28pin-SOP, 32pin-SOP, 52pin- μ TSSOP, 36pin-SOJ, 44pin-SOJ）に関して、供給安定性を目的とした組立拠点変更と、供給安定性および実装信頼性の更なる向上を目的とした組立材料等の変更を進めさせて頂く運びとなりました。

また、マガジン品とテープ&リール品の出荷梱包仕様を一部変更いたします。

趣旨ご理解の上、変更後製品の早期ご承認を賜りますよう、何卒よろしくごお願い申し上げます。

2. 変更内容

変更内容は、下記(1),(2)の2つに分類されます。

(1) 対象パッケージ：32pin-SOP

対象製品：R1LP0108ESN-5SI, R1LV0108ESN-5SI, R1LP0408DSP-5SI, RMLV0408EGSP-4S2

比較表

項目		変更前	変更後	
組立	拠点名称	Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd.	Greatek Electronics Inc.	
	所在地 (国名)	中国	台湾	
	材料	リードフレーム母材	Cu	変更なし
		リード外装メッキ材	Sn	変更なし
	パッケージ表面： マーキング仕様	現行仕様 詳細は別紙をご参照ください。	変更なし	
防湿梱包性能	MSL3	変更なし		
梱包仕様	マガジン品 (チューブ品)	現行仕様	新仕様	
		マガジンの寸法が変更になります。詳細は別紙をご参照ください。		
	テープ&リール品	現行仕様	新仕様	
		エンボステープの寸法が変更になります。詳細は別紙をご参照ください。		

変更前後において、

- ・パッケージ外形サイズ、実装互換性、ピン配置は、変更ございません。
- ・組立拠点変更に伴い、リードフレームのインナーリード形状とチップ厚は変更となります。
ただし、リードフレーム母材、外装メッキ材、防湿梱包性能は変更ありません。
- ・製品の電気的特性 (DC/AC)、信頼性、品質レベルは同等です。
- ・詳細は別紙 (CST-R2-AJ127 補足資料) をご参照ください。

(2) 対象パッケージ：28pin-SOP, 52pin- μ TSOP, 36pin-SOJ, 44pin-SOJ

対象製品：R1LP5256ESP-5SI, R1LV5256ESP-5SI

RMLV0816BGSD-4S2, RMLV1616AGSD-5S2

R1RP0408DGE-2LR/-2PI/-2PR

R1RW0408DGE-2LR/-2PI/-2PR

R1RP0416DGE-2LR/-2PI/-2PR/-2SR/-2UR/-2VR

R1RW0416DGE-2LR/-2PI/-2PR

比較表

項目		変更前	変更後	
組立	拠点名称	Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd.	Greatek Electronics Inc.	
	所在地 (国名)	中国	台湾	
	材料	リードフレーム母材	42Alloy	Cu
		リード外装めっき材	Sn-Cu	純 Sn
	パッケージ表面： マーキング仕様	28pin-SOP	現行仕様	変更なし
52pin- μ TSOP, 36pin-SOJ, 44pin-SOJ		現行仕様 詳細は別紙をご参照ください	新仕様	
防湿梱包性能		MSL2	MSL3	
梱包仕様	マガジン品 (チューブ品)	現行仕様	新仕様	
		・マガジンの寸法が変更になります。詳細は別紙をご参照ください。		
	テープ&リール品	現行仕様	新仕様	
		・エンボステープの寸法が変更になります。詳細は別紙をご参照ください。		

変更前後において、

- ・パッケージ外形、実装互換性、ピン配置は、変更ございません。
- ・実装信頼性の更なる向上を目的として、リードフレーム母材を、42Alloy から Cu に変更します。それに伴い、防湿梱包性能が MSL2 から MSL3 に変更となります。また、組立拠点変更に伴い、リードフレームのインナーリード形状とチップ厚も変更となります。
- ・リード外装めっき材を Sn-Cu から純 Sn に変更します。
- ・製品の電気的特性 (DC/AC)、信頼性、品質レベルは同等です。
- ・詳細は別紙 (CST-R2-AJ127 補足資料) をご参照ください。

3. サンプル及びその他情報の提供予定日

サンプル出荷予定日	52pin- μ TSOP, 36pin-SOJ, 44pin-SOJ : 2019年3月 28pin-SOP, 32pin-SOP : 2019年8月
信頼度データ 提出予定日	上記と同じ。

4. 識別方法

出荷梱包ラベルに記載の発注型名により、変更前後での製品識別が可能です。

5. スケジュール

現行のRSB組立 低消費電力SRAM製品の生産中止スケジュールは下記の通りです。

・ 52pin- μ TSOP, 36pin-SOJ, 44pin-SOJ :

生産中止予告 : 2018年12月
 保守取りまとめ : 2019年6月
 最終発注期限 : 2019年12月
 出荷終了予定時期 : 2020年12月

・ 28pin-SOP, 32pin-SOP :

生産中止予告 : 2019年6月
 保守取りまとめ : 2019年12月
 最終発注期限 : 2020年6月
 出荷終了予定時期 : 2020年12月

なお、後継製品の出荷開始予定時期は下記の通りです。

- ・ 52pin- μ TSOP, 36pin-SOJ, 44pin-SOJ : 2019年6月
- ・ 28pin-SOP, 32pin-SOP : 2019年11月

6. 補足説明

別紙 (CST-R2-AJ127 補足資料) をご参照下さい。

7. 製品リスト

パッケージ タイプ	メモリ容量, 電源電圧	発注型名	
		変更前	変更後
28pin-SOP	256Kb 5V	R1LP5256ESP-5SI#B0	R1LP5256ESP-5SI#B1
		R1LP5256ESP-5SI#S0	R1LP5256ESP-5SI#S1
	256Kb 3V	R1LV5256ESP-5SI#B0	R1LV5256ESP-5SI#B1
		R1LV5256ESP-5SI#S0	R1LV5256ESP-5SI#S1
32pin-SOP	1Mb 5V	R1LP0108ESN-5SI#B0	R1LP0108ESN-5SI#B1
		R1LP0108ESN-5SI#S0	R1LP0108ESN-5SI#S1
	1Mb 3V	R1LV0108ESN-5SI#B0	R1LV0108ESN-5SI#B1
		R1LV0108ESN-5SI#S0	R1LV0108ESN-5SI#S1
	4Mb 5V	R1LP0408DSP-5SI#B0	R1LP0408DSP-5SI#B1
		R1LP0408DSP-5SI#S0	R1LP0408DSP-5SI#S1
	4Mb 3V	RMLV0408EGSP-4S2#CA0	RMLV0408EGSP-4S2#CA1
		RMLV0408EGSP-4S2#HA0	RMLV0408EGSP-4S2#HA1
52pin-μTSOP	8Mb 3V	RMLV0816BGSD-4S2#AC0	RMLV0816BGSD-4S2#AA1
		RMLV0816BGSD-4S2#HC0	RMLV0816BGSD-4S2#HA1
	16Mb 3V	RMLV1616AGSD-5S2#AC0	RMLV1616AGSD-5S2#AA1
		RMLV1616AGSD-5S2#HC0	RMLV1616AGSD-5S2#HA1
36pin-SOJ	4Mb Fast 5V	R1RP0408DGE-2LR#B0	R1RP0408DGE-2LR#B1
		R1RP0408DGE-2PI#B0	R1RP0408DGE-2PI#B1
		R1RP0408DGE-2PR#B0	R1RP0408DGE-2PR#B1
	4Mb Fast 3V	R1RW0408DGE-2LR#B0	R1RW0408DGE-2LR#B1
		R1RW0408DGE-2PI#B0	R1RW0408DGE-2PI#B1
		R1RW0408DGE-2PR#B0	R1RW0408DGE-2PR#B1
44pin-SOJ	4Mb Fast 5V	R1RP0416DGE-2LR#B0/#BN	R1RP0416DGE-2LR#B1
		R1RP0416DGE-2PI#B0	R1RP0416DGE-2PI#B1
		R1RP0416DGE-2PR#B0/#BN	R1RP0416DGE-2PR#B1
		R1RP0416DGE-2SR#B0	R1RP0416DGE-2SR#B1
		R1RP0416DGE-2UR#B0	R1RP0416DGE-2UR#B1
		R1RP0416DGE-2VR#B0	R1RP0416DGE-2VR#B1
	4Mb Fast 3V	R1RW0416DGE-2LR#B0	R1RW0416DGE-2LR#B1
		R1RW0416DGE-2PI#B0	R1RW0416DGE-2PI#B1
		R1RW0416DGE-2PR#B0	R1RW0416DGE-2PR#B1

別紙：CST-R2-AJ127 補足資料

本別紙は、CST-R2-AJ127 (Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd. (以下、Renesas Semiconductor Beijing) 組立SRAM製品：組立拠点および組立材料等の変更) の補足資料として、変更前後での比較について記載しております。誠に恐縮ではございますが、主旨ご理解の上、変更後製品の早期ご承認を賜ります様、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

目次

1. 対象型名リスト	p.2
2. 変更前後の比較	pp.3-14
3. 梱包仕様の変更内容	pp.15-16
4. 出荷梱包ラベル仕様	p.17
5. 改訂記録	p.18

1. 対象型名リスト

パッケージ タイプ	メモリ容量, 電源電圧	語 構成	発注型名		梱包仕様	変更前後 比較表の 参照ページ
			変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)		
28pin- SOP	256Kb 5V	x8	R1LP5256ESP-5SI#B0	R1LP5256ESP-5SI#B1	マガジン	p.3
			R1LP5256ESP-5SI#S0	R1LP5256ESP-5SI#S1	テープ&リール	
	256Kb 3V	x8	R1LV5256ESP-5SI#B0	R1LV5256ESP-5SI#B1	マガジン	p.4
			R1LV5256ESP-5SI#S0	R1LV5256ESP-5SI#S1	テープ&リール	
32pin- SOP	1Mb 5V	x8	R1LP0108ESN-5SI#B0	R1LP0108ESN-5SI#B1	マガジン	p.5
			R1LP0108ESN-5SI#S0	R1LP0108ESN-5SI#S1	テープ&リール	
	1Mb 3V	X8	R1LV0108ESN-5SI#B0	R1LV0108ESN-5SI#B1	マガジン	p.6
			R1LV0108ESN-5SI#S0	R1LV0108ESN-5SI#S1	テープ&リール	
	4Mb 5V	X8	R1LP0408DSP-5SI#B0	R1LP0408DSP-5SI#B1	マガジン	p.7
			R1LP0408DSP-5SI#S0	R1LP0408DSP-5SI#S1	テープ&リール	
	4Mb 3V	x8	RMLV0408EGSP-4S2#CA0	RMLV0408EGSP-4S2#CA1	マガジン	p.8
			RMLV0408EGSP-4S2#HA0	RMLV0408EGSP-4S2#HA1	テープ&リール	
52pin- μTSOP	8Mb 3V	X16	RMLV0816BGSD-4S2#AC0	RMLV0816BGSD-4S2#AA1	トレイ	p.9
			RMLV0816BGSD-4S2#HC0	RMLV0816BGSD-4S2#HA1	テープ&リール	
	16Mb 3V	x16	RMLV1616AGSD-5S2#AC0	RMLV1616AGSD-5S2#AA1	トレイ	p.10
			RMLV1616AGSD-5S2#HC0	RMLV1616AGSD-5S2#HA1	テープ&リール	
36pin- SOJ	4Mb Fast 5V	x8	R1RP0408DGE-2LR#B0	R1RP0408DGE-2LR#B1	マガジン	p.11
			R1RP0408DGE-2PI#B0	R1RP0408DGE-2PI#B1		
			R1RP0408DGE-2PR#B0	R1RP0408DGE-2PR#B1		
	4Mb Fast 3V	x8	R1RW0408DGE-2LR#B0	R1RW0408DGE-2LR#B1	マガジン	p.12
			R1RW0408DGE-2PI#B0	R1RW0408DGE-2PI#B1		
			R1RW0408DGE-2PR#B0	R1RW0408DGE-2PR#B1		
44pin- SOJ	4Mb Fast 5V	x16	R1RP0416DGE-2LR#B0	R1RP0416DGE-2LR#B1	マガジン	p.13
			R1RP0416DGE-2LR#BN			
			R1RP0416DGE-2PI#B0	R1RP0416DGE-2PI#B1		
			R1RP0416DGE-2PR#B0	R1RP0416DGE-2PR#B1		
			R1RP0416DGE-2PR#BN			
			R1RP0416DGE-2SR#B0	R1RP0416DGE-2SR#B1		
			R1RP0416DGE-2UR#B0	R1RP0416DGE-2UR#B1		
	R1RP0416DGE-2VR#B0	R1RP0416DGE-2VR#B1				
	4Mb Fast 3V	x16	R1RW0416DGE-2LR#B0	R1RW0416DGE-2LR#B1	マガジン	p.14
			R1RW0416DGE-2PI#B0	R1RW0416DGE-2PI#B1		
R1RW0416DGE-2PR#B0			R1RW0416DGE-2PR#B1			

2. 変更前後の比較

(1) 28pin-SOP 256Kb(5V) 製品型名：R1LP5256ESP-5SI

項目		変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)
発注型名		R1LP5256ESP-5SI#B0 (マガジン品)	R1LP5256ESP-5SI#B1 (マガジン品)
		R1LP5256ESP-5SI#S0 (Tape & Reel品)	R1LP5256ESP-5SI#S1 (Tape & Reel品)
組立拠点		Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
JEITA Package Code		P-SOP28-8.4x17.5-1.27	←
パッケージ表面仕様		<p>XXXXXXXX → デートコード R1LP5256ESP → 製品型名 -5SI → 電気特性</p>	←
アセンブリ材料	リードフレーム材質	42Alloy	Cu
	インナーリード形状	現行形状	変更あり
	アウターリード形状	現行形状	変更なし
	リードめっき材	Sn-Cu	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (非ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚		現行チップ厚	変更あり
選別テスト拠点		Powertech Technology Inc. (台湾)	←
マガジン品	マガジン	マガジン型名：MP024PC	新仕様
	収納数	30pcs/magazine	←
	マガジン本数 (Max.)	40本	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	595mm x 170mm x 72mm	←
Tape & Reel品	エンボステーブ	エンボス型名：MTE2416H-28P2W-C	←
	収納数	1,000pcs/reel	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	362mm x 340mm x 60mm	←
防湿梱包性能		MSL 2	MSL 3
出荷梱包ラベル		現行仕様	フォーマットの変更なし (発注型名、原産国、MSL表示は変更)

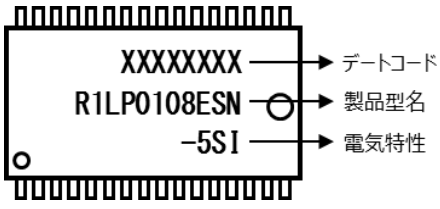
・マガジンの仕様変更については、Page 15をご参照ください。

(2) 28pin-SOP 256Kb(3V) 製品型名 : R1LV5256ESP-5SI

項目	変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)	
発注型名	R1LV5256ESP-5SI#B0 (マガジン品)	R1LV5256ESP-5SI#B1 (マガジン品)	
	R1LV5256ESP-5SI#S0 (Tape & Reel品)	R1LV5256ESP-5SI#S1 (Tape & Reel品)	
組立拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
JEITA Package Code	P-SOP28-8.4x17.5-1.27	←	
パッケージ表面仕様	<p>XXXXXXXX → デートコード R1LV5256ESP → 製品型名 -5SI → 電気特性</p>	←	
アセンブリ材料	リードフレーム材質	42Alloy	Cu
	インナーリード形状	現行形状	変更あり
	アウターリード形状	現行形状	変更なし
	リードめっき材	Sn-Cu	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (非ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	現行チップ厚	変更あり	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
マガジン品	マガジン	マガジン型名 : MP024PC	新仕様
	収納数	30pcs/magazine	←
	マガジン本数 (Max.)	40本	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	595mm x 170mm x 72mm	←
Tape & Reel品	エンボステーブ	エンボス型名 : MTE2416H-28P2W-C	←
	収納数	1,000pcs/reel	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	362mm x 340mm x 60mm	←
防湿梱包性能	MSL 2	MSL 3	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (発注型名、原産国、MSL表示は変更)	

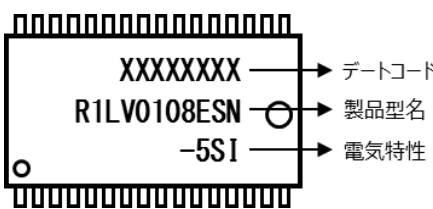
・ マガジンの仕様変更については、Page 15をご参照ください。

(3) 32pin-SOP 1Mb(5V) 製品型名：R1LP0108ESN-5SI

項目		変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)
発注型名		R1LP0108ESN-5SI#B0 (マガジン品)	R1LP0108ESN-5SI#B1 (マガジン品)
		R1LP0108ESN-5SI#S0 (Tape & Reel品)	R1LP0108ESN-5SI#S1 (Tape & Reel品)
組立拠点		Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
JEITA Package Code		P-SOP32-11.4x20.75-1.27	←
パッケージ表面仕様			←
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状	変更あり
	アウターリード形状	現行形状	変更なし
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	現行チップ厚	変更あり	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
マガジン品	マガジン	マガジン型名：MP525PC	新仕様
	収納数	25pcs/magazine	←
	マガジン本数 (Max.)	36本	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	595mm x 170mm x 72mm	←
Tape & Reel品	エンボステーブ	エンボス型名：MTE3216H-32P2M-A	新仕様
	収納数	1,000pcs/reel	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	362mm x 340mm x 60mm	←
防湿梱包性能	MSL 3	←	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (発注型名、原産国表示は変更)	

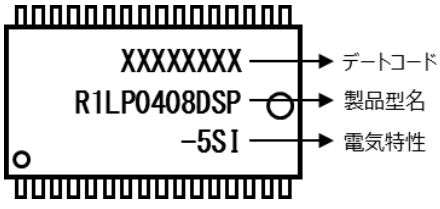
- ・ マガジンの仕様変更については、Page 15をご参照ください。
- ・ エンボステーブの仕様変更については、Page 16をご参照ください。

(4) 32pin-SOP 1Mb(3V) 製品型名：R1LV0108ESN-5SI

項目	変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)	
発注型名	R1LV0108ESN-5SI#B0 (マガジン品)	R1LV0108ESN-5SI#B1 (マガジン品)	
	R1LV0108ESN-5SI#S0 (Tape & Reel品)	R1LV0108ESN-5SI#S1 (Tape & Reel品)	
組立拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
JEITA Package Code	P-SOP32-11.4x20.75-1.27	←	
パッケージ表面仕様			
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状	変更あり
	アウターリード形状	現行形状	変更なし
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	現行チップ厚	変更あり	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
マガジン品	マガジン	マガジン型名：MP525PC	新仕様
	収納数	25pcs/magazine	←
	マガジン本数 (Max.)	36本	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	595mm x 170mm x 72mm	←
Tape & Reel品	エンボステーブ	エンボス型名：MTE3216H-32P2M-A	新仕様
	収納数	1,000pcs/reel	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	362mm x 340mm x 60mm	←
防湿梱包性能	MSL 3	←	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (発注型名、原産国表示は変更)	

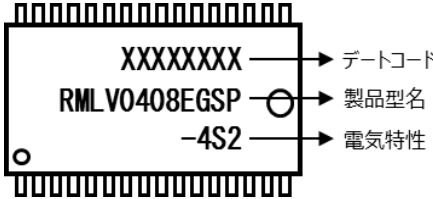
- ・ マガジンの仕様変更については、Page 15をご参照ください。
- ・ エンボステーブの仕様変更については、Page 16をご参照ください。

(5) 32pin-SOP 4Mb(5V) 製品型名： R1LP0408DSP-5SI

項目	変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)	
発注型名	R1LP0408DSP-5SI#B0 (マガジン品)	R1LP0408DSP-5SI#B1 (マガジン品)	
	R1LP0408DSP-5SI#S0 (Tape & Reel品)	R1LP0408DSP-5SI#S1 (Tape & Reel品)	
組立拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Gretek Electronics Inc. (台湾)	
JEITA Package Code	P-SOP32-11.4x20.75-1.27	←	
パッケージ表面仕様		←	
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状	変更あり
	アウターリード形状	現行形状	変更なし
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	現行チップ厚	変更あり	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
マガジン品	マガジン	マガジン型名：MP525PC	新仕様
	収納数	25pcs/magazine	←
	マガジン本数 (Max.)	36本	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	595mm x 170mm x 72mm	←
Tape & Reel品	エンボステーブ	エンボス型名：MTE3216H-32P2M-A	新仕様
	収納数	1,000pcs/reel	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	362mm x 340mm x 60mm	←
防湿梱包性能	MSL 3	←	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (発注型名、原産国表示は変更)	

- ・ マガジンの仕様変更については、Page 15をご参照ください。
- ・ エンボステーブの仕様変更については、Page 16をご参照ください。

(6) 32pin-SOP 4Mb(3V) 製品型名 : RMLV0408EGSP-4S2

項目		変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)
発注型名		RMLV0408EGSP-4S2#CA0 (マガジン品)	RMLV0408EGSP-4S2#CA1 (マガジン品)
		RMLV0408EGSP-4S2#HA0 (Tape & Reel品)	RMLV0408EGSP-4S2#HA1 (Tape & Reel品)
組立拠点		Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
JEITA Package Code		P-SOP32-11.4x20.75-1.27	←
パッケージ表面仕様			
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状	変更あり
	アウターリード形状	現行形状	変更なし
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚		現行チップ厚	変更あり
選別テスト拠点		Powertech Technology Inc. (台湾)	←
マガジン品	マガジン	マガジン型名 : MP525PC	新仕様
	収納数	25pcs/magazine	←
	マガジン本数 (Max.)	36本	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	595mm x 170mm x 72mm	←
Tape & Reel品	エンボステーブ	エンボス型名 : MTE3216H-32P2M-A	新仕様
	収納数	1,000pcs/reel	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	362mm x 340mm x 60mm	←
防湿梱包性能		MSL 3	←
出荷梱包ラベル		現行仕様	フォーマットの変更なし (発注型名、原産国表示は変更)

- ・ マガジンの仕様変更については、Page 15をご参照ください。
- ・ エンボステーブの仕様変更については、Page 16をご参照ください。

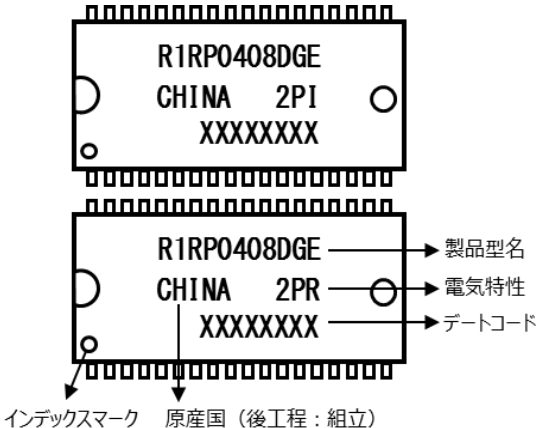
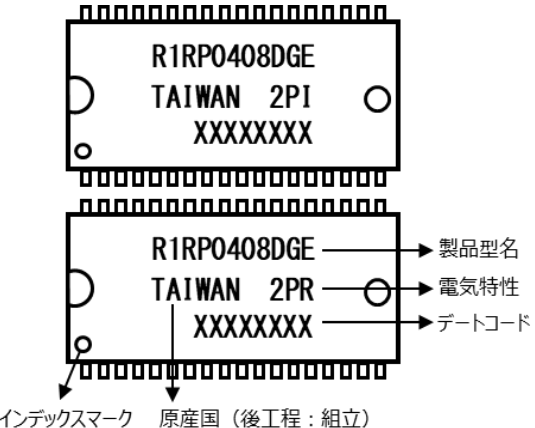
(7) 52pin-μTSOP 8Mb(3V) 製品型名：RMLV0816BGSD-4S2

項目		変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)
発注型名		RMLV0816BGSD-4S2#AC0 (トレイ品)	RMLV0816BGSD-4S2#AA1 (トレイ品)
		RMLV0816BGSD-4S2#HC0 (Tape & Reel品)	RMLV0816BGSD-4S2#HA1 (Tape & Reel品)
組立拠点		Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
JEITA Package Code		P-TSOP(2)52-8.89x10.79-0.40	←
パッケージ表面仕様			
アセンブリ材料	リードフレーム材質	42Alloy	Cu
	インナーリード形状	現行形状	変更あり
	アウターリード形状	現行形状	変更なし
	リードめっき材	Sn-Cu	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂フィルム	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (非ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚		現行チップ厚	変更あり
選別テスト拠点		Powertech Technology Inc. (台湾)	←
トレイ品	トレイ	JEDEC Tray ルネサスロゴ有り (型名：L196-24)	←
	収納数	230pcs/tray	←
	トレイ段数 (Max.)	10枚 + 1枚 (フタ)	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	351mm x 175mm x 104mm	←
Tape & Reel品	エンボステーブ	エンボス型名：MTE2416H-52PTG-A	変更なし
	収納数	1,000pcs/reel	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	289mm x 264mm x 60mm	←
防湿梱包性能		MSL 2	MSL 3
出荷梱包ラベル		現行仕様	フォーマットの変更なし (発注型名、原産国、MSL表示は変更)

(8) 52pin-μTSP 16Mb(3V) 製品型名：RMLV1616AGSD-5S2

項目		変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)
発注型名		RMLV1616AGSD-5S2#AC0 (トレイ品)	RMLV1616AGSD-5S2#AA1 (トレイ品)
		RMLV1616AGSD-5S2#HC0 (Tape & Reel品)	RMLV1616AGSD-5S2#HA1 (Tape & Reel品)
組立拠点		Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
JEITA Package Code		P-TSOP(2)52-8.89x10.79-0.40	←
パッケージ表面仕様			
アセンブリ材料	リードフレーム材質	42Alloy	Cu
	インナーリード形状	現行形状	変更あり
	アウターリード形状	現行形状	変更なし
	リードめっき材	Sn-Cu	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂フィルム	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (非ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚		現行チップ厚	変更あり
選別テスト拠点		Powertech Technology Inc. (台湾)	←
トレイ品	トレイ	JEDEC Tray ルネサスロゴ有り (型名：L196-24)	←
	収納数	230pcs/tray	←
	トレイ段数 (Max.)	10枚 + 1枚 (フタ)	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	351mm x 175mm x 104mm	←
Tape & Reel品	エンボステーブ	エンボス型名：MTE2416H-52PTG-A	変更なし
	収納数	1,000pcs/reel	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	289mm x 264mm x 60mm	←
防湿梱包性能		MSL 2	MSL 3
出荷梱包ラベル		現行仕様	フォーマットの変更なし (発注型名、原産国、MSL表示は変更)

(9) 36pin-SOJ 4Mb Fast(5V) x8 製品型名 : R1RP0408DGE-***

項目	変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)	
発注型名	R1RP0408DGE-2LR/-2PI/-2PR#B0 (マガジン品)	R1RP0408DGE-2LR/-2PI/-2PR#B1 (マガジン品)	
組立拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
マーキング原産国表示	CHINA	TAIWAN	
JEITA Package Code	P-SOJ36-10.16x23.39-1.27	←	
パッケージ表面仕様 (図は一例)			
アセンブリ 材料	リードフレーム材質	42Alloy	Cu
	インナーリード形状	現行形状	変更あり
	アウターリード形状	現行形状	変更なし
	リードめっき材	Sn-Cu	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂フィルム	樹脂ペースト
	ボンディング ワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (非ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	現行チップ厚	変更あり	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
マガジン 品	マガジン	マガジン型名 : JP400PC	新仕様
	収納数	22pcs/magazine	←
	マガジン本数 (Max.)	60本	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	595mm x 170mm x 72mm	←
防湿梱包性能	MSL 2	MSL 3	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (発注型名、原産国、MSL表示は変更)	

- ・ マガジンの仕様変更については、Page 15をご参照ください。
- ・ 本製品につきましては、変更前後ともに、パッケージ表面のレーザーマーキングを選別テスト拠点で実施しております。

(10) 36pin-SOJ 4Mb Fast(3V) x8 製品型名： R1RW0408DGE-***

項目	変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)	
発注型名	R1RW0408DGE-2LR/-2PI/-2PR#B0 (マガジン品)	R1RW0408DGE-2LR/-2PI/-2PR#B1 (マガジン品)	
組立拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
マーキング原産国表示	CHINA	TAIWAN	
JEITA Package Code	P-SOJ36-10.16x23.39-1.27	←	
パッケージ表面仕様 (図は一例)			
アセンブリ 材料	リードフレーム材質	42Alloy	Cu
	インナーリード形状	現行形状	変更あり
	アウターリード形状	現行形状	変更なし
	リードめっき材	Sn-Cu	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂フィルム	樹脂ペースト
	ボンディング ワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (非ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	現行チップ厚	変更あり	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
マガジン 品	マガジン	マガジン型名：JP400PC	新仕様
	収納数	22pcs/magazine	←
	マガジン本数 (Max.)	60本	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	595mm x 170mm x 72mm	←
防湿梱包性能	MSL 2	MSL 3	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (発注型名、原産国、MSL表示は変更)	

- ・ マガジンの仕様変更については、Page 15をご参照ください。
- ・ 本製品につきましては、変更前後ともに、パッケージ表面のレーザーマーキングを選別テスト拠点で実施しております。

(11) 44pin-SOJ 4Mb Fast(5V) x16 製品型名 : R1RP0416DGE-***

項目	変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)	
発注型名	R1RP0416DGE -2LR/-2PI/-2PR/-2SR/-2UR/-2VR#B0 (マガジン品) -2LR/-2PR#BN (マガジン品)	R1RP0416DGE -2LR/-2PI/-2PR/-2SR/-2UR/-2VR#B1 (マガジン品)	
組立拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
マーキング原産国表示	CHINA	TAIWAN	
JEITA Package Code	P-SOJ44-10.16x28.47-1.27	←	
パッケージ表面仕様 (図は一例)			
アセンブリ 材料	リードフレーム材質	42Alloy	Cu
	インナーリード形状	現行形状	変更あり
	アウターリード形状	現行形状	変更なし
	リードめっき材	Sn-Cu	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂フィルム	樹脂ペースト
	ボンディング ワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (非ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	現行チップ厚	変更あり	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
マガジン 品	マガジン	マガジン型名 : JP400PC	新仕様
	収納数	18pcs/magazine	←
	マガジン本数 (Max.)	60本	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	595mm x 170mm x 72mm	←
防湿梱包性能	MSL 2	MSL 3	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (発注型名、原産国、MSL表示は変更)	

- ・ マガジンの仕様変更については、Page 15をご参照ください。
- ・ 本製品につきましては、変更前後ともに、パッケージ表面のレーザーマーキングを選別テスト拠点で実施しております。

(12) 44pin-SOJ 4Mb Fast(3V) x16 製品型名 : R1RW0416DGE-***

項目	変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)	
発注型名	R1RW0416DGE-2LR/-2PI/-2PR#B0 (マガジン品)	R1RW0416DGE-2LR/-2PI/-2PR#B1 (マガジン品)	
組立拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
マーキング原産国表示	CHINA	TAIWAN	
JEITA Package Code	P-SOJ44-10.16x28.47-1.27	←	
パッケージ表面仕様 (図は一例)	<p>製品型名 電気特性 デートコード</p> <p>インデックスマーク 原産国 (後工程 : 組立)</p>	<p>製品型名 電気特性 デートコード</p> <p>インデックスマーク 原産国 (後工程 : 組立)</p>	
アセンブリ 材料	リードフレーム材質	42Alloy	Cu
	インナーリード形状	現行形状	変更あり
	アウターリード形状	現行形状	変更なし
	リードめっき材	Sn-Cu	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂フィルム	樹脂ペースト
	ボンディング ワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (非ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	現行チップ厚	変更あり	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
マガジン 品	マガジン	マガジン型名 : JP400PC	新仕様
	収納数	18pcs/magazine	←
	マガジン本数 (Max.)	60本	←
	内装箱サイズ (LxWxH)	595mm x 170mm x 72mm	←
防湿梱包性能	MSL 2	MSL 3	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (発注型名、原産国、MSL表示は変更)	

- ・ マガジンの仕様変更については、Page 15をご参照ください。
- ・ 本製品につきましては、変更前後ともに、パッケージ表面のレーザーマーキングを選別テスト拠点で実施しております。

3. 梱包仕様の変更内容

(1) マガジン変更内容

- ・ マガジンにおける断面形状が変更になります。下記の図をご参照ください。
- ・ なお、マガジンの長さは、550mm から変更ございません。

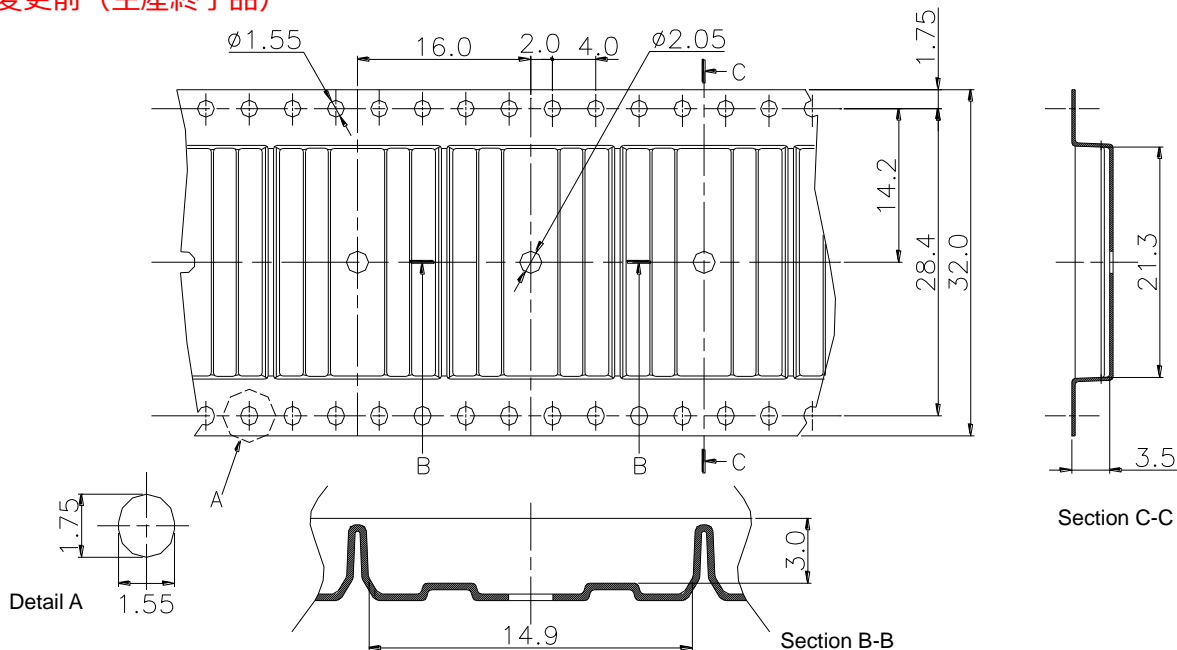
	変更前 (生産終了品)	変更後 (後継製品)
28pin-SOP (単位:mm)	<p>W:20 10.5 8.5 7.6 4 5.7 2.7 1.5 2 1 5 7</p>	<p>W: 20 9.1 5.7 2.8 1.4 1.9 5</p>
32pin-SOP (単位:mm)	<p>W:20 14 11.7 7 6.4 3.4 2.3 2 1 7 9 18</p>	<p>W: 20 11.5 6.3 3.2 2.0 2.1 7</p>
36pin-SOJ 44pin-SOJ (単位:mm)	<p>W:13.6 0.7 1.9 6 4.6</p>	<p>W:13.6 0.7 1.9 6 4.6</p>

(2) 32pin-SOP テープ&リール変更内容

- ・エンボステープにおけるポケット形状、サイズが変更になります。ただし、パッケージ着座高さは変更ございません。変更前後での比較は下記をご参照ください。
- ・エンボステープ幅、エンボステープピッチ、リール径の変更はございません。

	エンボステープ幅	エンボステープピッチ	ポケットサイズ	パッケージ着座高さ	リール径
変更前 (生産終了品)	32mm	16mm	14.9mm x 21.3mm	3.0mm	330mm
変更後 (後継製品)	32mm	16mm	14.6mm x 20.9mm	3.0mm	330mm

変更前 (生産終了品)



変更後 (後継製品)

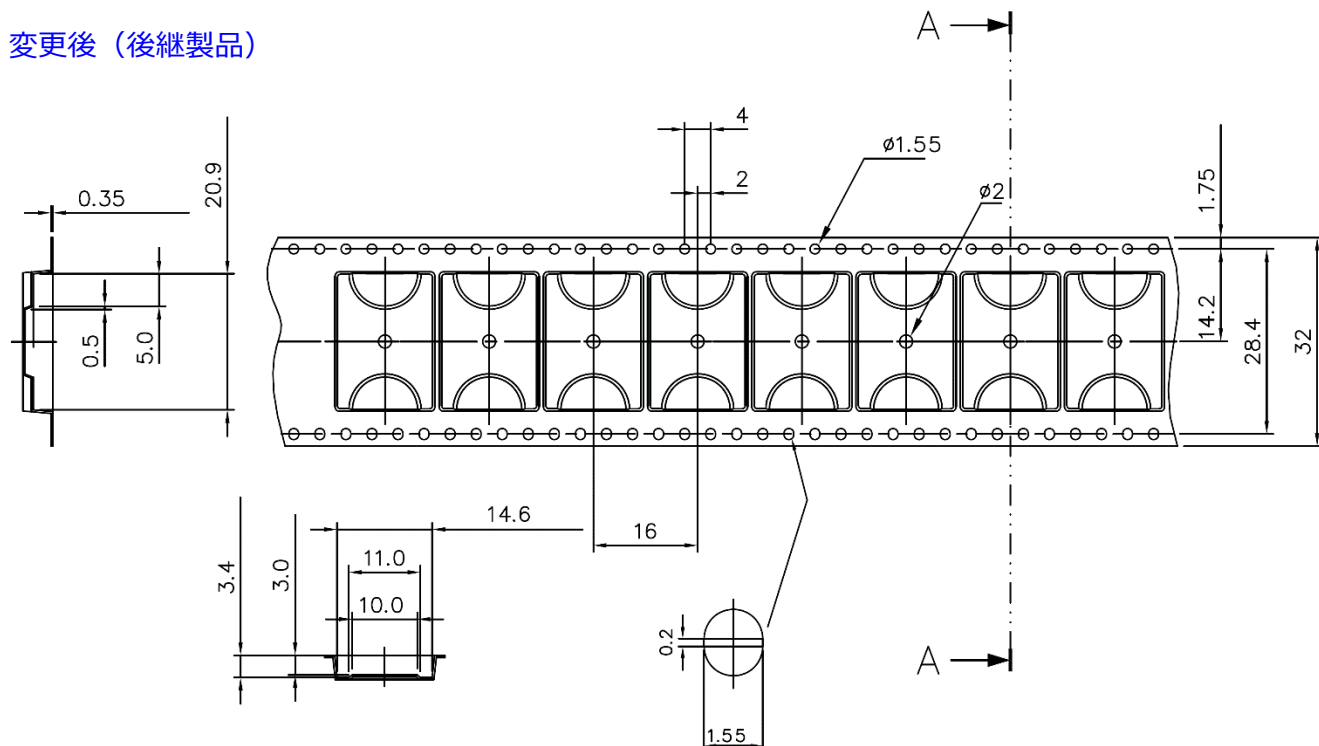


図. 32pin-SOP エンボステープ寸法 (単位: mm)

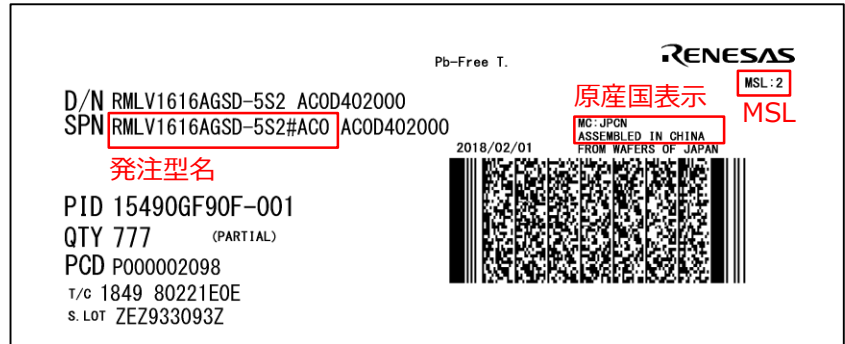
4. 出荷梱包ラベル仕様

- ・ラベルフォーマット自体の変更はございません。
- ・「発注型名」、「原産国表示」、「MSL表示」の記載内容が変更になります。下記のラベル例をご参照ください。
(32pin-SOP製品 : R1LP0108ESN-5SI, R1LV0108ESN-5SI, R1LP0408DSP-5SI, RMLV0408EGSP-4S2 については、MSL表示は、MSL3 から変更ございません。)

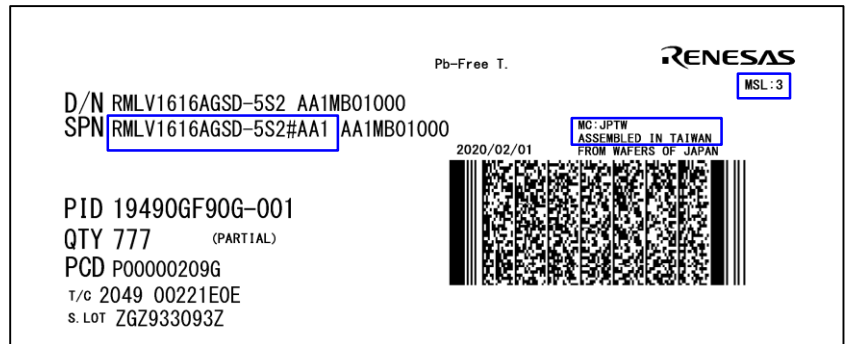
(1) 発注型名が

RM で始まる製品

変更前
(生産終了品)



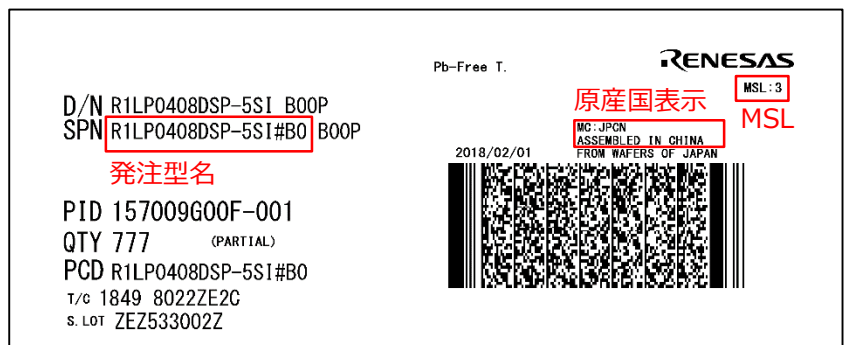
変更後
(後継製品)



(2) 発注型名が

R1 で始まる製品

変更前
(生産終了品)



変更後
(後継製品)



改定記録

別紙：CST-R2-AJ127 補足資料

Rev.	発行日	改訂内容
1.00	2018/8/1	初版発行
1.01	2018/8/24	インボステーブ寸法図を追加
1.02	2019/4/22	p.9, p.10 : ・ 52pin- μ TSOPのインボステーブの変更後（後継製品）の仕様を、「新仕様」から「変更なし」に修正。 ・ 脚注の「インボステーブの仕様変更については、Page 17をご参照ください。」を削除。 Rev1.01のp.17 : ・ 52pin- μ TSOP テープ&リール変更内容のページ削除
1.03	2020/2/13	p.15 : ・ 28pin-SOP と 32pin-SOP のマガジンの変更後（後継製品）の断面形状（寸法）の図を修正。